

APR-5000

BGA, CSP, LGA, MLF 부품제거 및 장착장비 (중형) Array Package Rework System

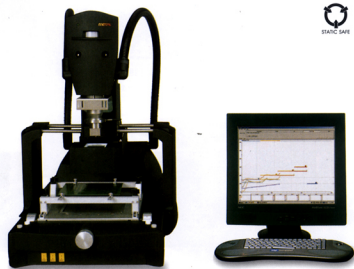
국제공인



최첨단 기술로 최고 품질의 제품을 생산하는 세계의 유수기업들이 사용합니다.



PC(컴퓨터), 소프트웨어
기본제공 (한글지원)



제품 특성

□ 간편한 작동

시간, 온도, Airflow의 조절이 컴퓨터로 가능하여 안정적이고 반복적인 작업에 최적. 소프트웨어 기본 제공 (한글지원)

□ 정밀한 작업

실장의 정확성-0.025mm, 부품의 내부 Pitch-0.3 mm까지 정밀한 제품에 사용되며, 저비용으로 휴대폰, PDA, 노트북과 같은 소형 전자제품의 Rework 작업에 최적.

□ 일체형 헤드

Reflow Head와 Placement가 일체형으로 불필요한 이동이 없으므로 작업에 수월.

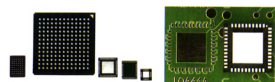
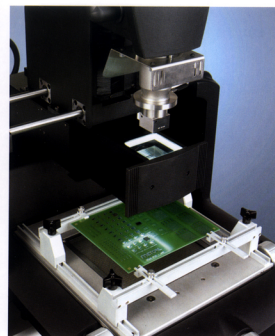
□ 무연납 솔더에 적용

무연납 솔더가 적용된 PCB의 Rework 작업에 필수적인 고온의 열을 전달하도록 개발된 제품.



- 컴퓨터 스크린 Controls 카메라가 자동으로 Setting됨.
- 컴퓨터를 사용하여 Following, Vision, 빛, 줌, 초점, 높이, 배치, 온도 프로파일을 Control 함.
- 자동기능이 설계되어 있어서 사용자마다 달라지는 오차를 없애줌.
- 숙련된 기술자 또는 비숙련 기술자도 손쉽게 설치 사용가능.
- 카메라에 보여지는 모든 Picture가 Video Shot로 찍혀질 수 있도록 Video Caption Card가 내장되어 DB로 활용가능.

36



특히 기술

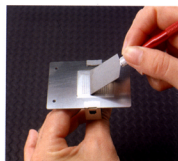
전세계 어떠한 제품도 모방할 수 없는 Nozzle의 대류순환기술, Cooling Air Flow 별도장치, Solder Cream Chip Stenciling 장치 등 많은 국제특허를 가지고 있다.

Specifications

- 전원 : 100-240 VAC
- Pre-Heater 소비전력 : 1400 W
- Reflow Head 소비전력 : 550 W - System (2200W)
- 최고온도 : 상부 450 °C, 하부 350 °C
- PCB크기 : 381 x 229 mm
- PCB두께 : ~6 mm
- 부품크기 : 최소 0.51 x 0.25 mm, 최대 45 x 45 mm 작업 가능
- 비전확대배율 : 10 ~50배
- 온도콘트롤 : Closed-loop Control (RTD Sensors)
- Air Flow : 8~24 l/min (기본내장형 Pump)
- Nitrogen(N2)연결 장치 : 기본 장착
- 제품크기 : 483 x 762 x762 mm
- 제품중량 : 60 kg

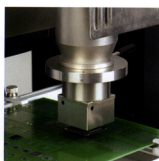
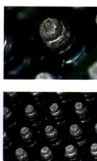
정밀한 작업가능 (휴대폰, PDA, 노트북의 PCB Rework에 최적)

- 크기가 381 x 229mm인 PCB 작업이 가능하고 실장의 정확성-0.025mm, 부품의 내부 Pitch-0.3mm 까지 Rework 가능.
- 저비용으로 휴대폰, 노트북과 같은 소형전자제품의 Rework에 적합.
- BGA, CSP, LGA(Land Grid Array), MLF(Micro-Lead Frame), Bumped Chip Component, Micro SMD의 Rework 작업에 있어서 성공적인 작업수행을 위한 Vision 시스템 장착, Micrometer 단위의 조작으로 부품실장 전에 PCB의 윗면 이미지와 부품일면 이미지를 X, Y, Z축으로 정확한 이동이 가능하여 작업자가 이미지 일치 작업을 완벽하게 수행



Component Stenciling Template

정밀성과 신뢰성이 높은 특허출원된 스텐실을 이용하여 부품에 직접 도포하는 방법으로써 편안하고 안정된 작업실현.



APR-5000 Nozzle

- 새로운 열풍 분배 시스템으로 부분별 온도편차를 해결.
- 스테인레스 재질을 레이저로 특수가공하여 뒤틀림 방지.
- Nozzle 뒷부분 대류순환기술로 특허출원.



37